

2018-2024年中国晶圆代工行业市场现状分析及投资前景预测报告

报告大纲

智研咨询

www.chyxx.com

一、报告简介

智研咨询发布的《2018-2024年中国晶圆代工行业市场现状分析及投资前景预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/201804/631895.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

晶圆制造属于技术及资本密集型行业，其最关键的技术为制造流程的精细化技术，为攻克最先进制程需巨额资本开支及研发投入。行业寡头竞争特征愈发明显，2016年全球前十大纯晶圆代工企业联合市场份额达94.2%。

大陆IC设计市场增长远高于全球，下游广袤市场吸引国内外厂商纷纷在大陆增设晶圆产能，抢食高速增长的大陆市场份额。当前中国大陆12寸及8寸现有晶圆产线合计36条（包括现有产线20条，在建及计划16条），其中超过50%的晶圆产线（包括现有12条，在建及计划8条）均集中在存储器或IDM业务（包括：三星、英特尔、SK海力士三大国际IDM厂商在大陆的晶圆产线，和大陆长江存储、晋华集成、士兰微等企业的晶圆产线），与纯晶圆代工业务重合度较小。

外资晶圆代工厂产能扩张均较为平稳；2021年大陆12寸晶圆代工厂产能将达457K/m，2016-2021

年间复合增速达24%，在内资及外资晶圆厂的共同推动下预计将进入快速扩张状态。

2016-2021年间大陆8寸内资晶圆厂及外资晶圆厂产能复合增速预测 - 220K（34%）429K（66%）2021年预计总产能及占比 281K（32%）584K（68%）2016-2021E CAGR 5% 6.40%

2016-2021年间大陆12寸内资晶圆厂及外资晶圆产能复合增速预测 - 16K（12%）116K（88%）2021年预计总产能及占比 98K（21%）359K（79%）2016-2021E CAGR 44% 25%

智研咨询发布的《2018-2024年中国晶圆代工行业市场现状分析及投资前景预测报告》共四章。首先介绍了中国晶圆代工行业市场发展环境、晶圆代工整体运行态势等，接着分析了中国晶圆代工行业市场运行的现状，然后介绍了晶圆代工市场竞争格局。随后，报告对晶圆代工做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国晶圆代工行业发展趋势与投资预测。您若想对晶圆代工产业有个系统的了解或者想投资中国晶圆代工行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章晶圆制造简介21

第一节晶圆制造流程21

第二节晶圆制造成本分析27

第二章半导体市场32

第一节2018-2023年半导体产业预测32

第二节2018年半导体市场下游预测34

第三节全球晶圆代工产业现状35

第四节全球半导体制造产业38

一、全球半导体产业概况38

二、全球晶圆代工行业概况39

第五节中国半导体产业与市场44

一、中国半导体市场44

二、中国半导体产业47

三、中国ic设计产业56

四、中国半导体产业发展趋势59

第三章晶圆代工产业简介61

第一节晶圆制造工艺简介61

第二节全球晶圆产业及主要厂商简介62

第三节中国半导体产业政策环境70

第四节中国晶圆制造业现状及预测73

合各晶圆代工厂中国区营收及晶圆ASP，预计2017H1

大陆市场晶圆代工出货量合计约4400K。考虑到大陆厂商ASP 相对更低，市场出货份额进一步向大陆厂商集中达67%。分厂商而言，台积电占据大陆市场最大出货，但份额收窄至28%。中芯国际以22%的份额紧随其后，华虹则以11%的市占率跻身前三。

2017H1大陆晶圆代工出货份额分布

2017H1大陆晶圆代工销售份额分布

第四章晶圆厂研究76 (ZY GXH)

一、中芯国际76

(一) 企业偿债能力分析77

(二) 企业运营能力分析79

(三) 企业盈利能力分析82

二、上海华虹nec电子有限公司83

(一) 企业偿债能力分析85

(二) 企业运营能力分析87

(三) 企业盈利能力分析90

三、上海宏力半导体制造有限公司92

(一) 企业偿债能力分析93

- (二) 企业运营能力分析95
- (三) 企业盈利能力分析98
- 四、华润微电子99
 - (一) 企业偿债能力分析100
 - (二) 企业运营能力分析102
 - (三) 企业盈利能力分析105
- 五、上海先进半导体106
 - (一) 企业偿债能力分析107
 - (二) 企业运营能力分析109
 - (三) 企业盈利能力分析112
- 六、和舰科技(苏州)有限公司113
 - (一) 企业偿债能力分析114
 - (二) 企业运营能力分析116
 - (三) 企业盈利能力分析119
- 七、bcd(新进半导体)制造有限公司120
 - (一) 企业偿债能力分析121
 - (二) 企业运营能力分析123
 - (三) 企业盈利能力分析126
- 八、方正微电子有限公司127
 - (一) 企业偿债能力分析128
 - (二) 企业运营能力分析130
 - (三) 企业盈利能力分析133
- 十、南通绿山集成电路有限公司134
 - (一) 企业偿债能力分析135
 - (二) 企业运营能力分析(ZY GXH) 137

图表目录：

- 图表1晶圆制造工艺流程21
- 图表2晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析27
- 图表32017年度全球营收前13的晶圆代工企业35
- 图表42018-2023年大陆ic内需市场规模变化与预测36
- 图表5主要代工企业产能分布及收益情况41
- 图表6集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用43
- 图表7全球半导体市场规模超过3000亿美元47
- 图表8半导体产品种类繁多48
- 图表9全球半导体分产品市场占比48

- 图表10中国大陆半导体市场规模近4000亿元49
 - 图表11全球半导体产业区域结构发生巨大变化50
 - 图表12北美半导体设备制造商bb值51
 - 图表13半导体产业链51
 - 图表14近期或者未来有望在a股上市的半导体厂商52
 - 图表15半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低53
 - 图表16封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒54
 - 图表17集成电路封测行业一直占据行业主导地位55
 - 图表18国内十大半导体封装测试企业56
 - 图表192017年全球晶圆代工排名63
 - 图表202015-2017年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势64
 - 图表21全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较65
 - 图表22前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势66
 - 图表23全球半导体厂商资本支出集中程度分析67
 - 图表24半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析68
 - 图表25全球半导体设备产业版图的变化69
 - 图表26国内政策对集成电路产业大力支持71
 - 图表27国内半导体进口金额超2000亿美元71
- 详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/201804/631895.html>